



SPEA e XJTAG hanno unito il meglio di Flying Probe e Boundary Scan

“I Test Engineers sono esposti ad una crescente sfida con schede che stanno vedendo un utilizzo sempre maggiore di componenti che prevedono un accesso limitato o addirittura nullo ai loro pin; inoltre, lo spazio utile per posizionare i test points sul PCB sta diventando sempre più scarso. SPEA ha assunto un ruolo guida nel mondo del test offrendo ai propri clienti una soluzione completa che prevede l’integrazione del boundary scan con i suoi sistemi di fama mondiale, flying probe e letto d’aghi.”

SPEA è un leader mondiale tra i produttori di strumenti di test automatici (ATE) al servizio dei settori dell’elettronica e semiconduttori, con clienti nei mercati aerospaziale, aeronautico, telecomunicazioni, automotive, medicale, dei consumer e sicurezza. I sistemi flying probe e letto d’aghi forniti da SPEA sono apparecchiature di test multi-funzione che utilizzano le tecniche aggiuntive quali l’ispezione ottica, controllo laser 3D e test open-pin per garantire una copertura di test massima. I clienti SPEA sono in grado di dare agli utenti finali la garanzia della perfetta prestazione delle schede nel corso di molti anni, con un conseguente livello minimo di ritorno dal campo.

Ogni nuova generazione di schede aumenta la sfida di mantenere elevato il livello di copertura dei test; ciò è dovuto ai PCB che diventano sempre più complessi e densamente popolati, al sempre più basso numero di test points disponibili, e ai nuovi tipi di package che compromettono la capacità di accedere ai pin di I/O con i probe. Per garantire un continuo miglioramento e per assicurare che la presenza di componenti BGA (Ball Grid Array) su schede ad alta densità non influenzi la copertura dei test, SPEA ha introdotto il test boundary scan sui sistemi letto d’aghi e flying probe.

Il boundary scan permette di controllare i dispositivi e le connessioni su net collegate a componenti JTAG sulla scheda, tramite un connettore di accesso dedicato. Nei casi in cui i pin di I/O del componente risultano inaccessibili o non vi sono test points disponibili, il boundary scan consente di mantenere un elevato livello di copertura del test e, inoltre, è anche

in grado di fornire una diagnostica accurata che consente di localizzare la posizione dei guasti rilevati.

I team di SPEA e XJTAG hanno lavorato a stretto contatto per garantire prestazioni superiori su una piattaforma di test combinato, con l’intento di fornire le migliori

risorse di test e un valore aggiunto per i propri clienti.

“Il test boundary scan ha diversi punti di forza che completano l’esperienza di SPEA nel campo del test”, spiega Stefano Ghibò, Technical Sales Specialist in SPEA. “XJTAG è un tool potente e facile da usare, che ci permette di massimizzare i vantaggi di una soluzione boundary scan integrata per i nostri clienti.”

Per completare l’integrazione tra le funzionalità del boundary scan e del test in-circuit, il team SPEA ha rielaborato la strategia di test globale per ottimizzare i tempi di ciclo di test. Il sistema combinato implementa anche un report di copertura di test

che unisce i dati relativi alle diverse tecniche di test utilizzate.”

Stefano Ghibò descrive il supporto fornito dai tecnici di entrambe le aziende come un punto fondamentale per supportare i clienti nei loro progetti. “I nostri tecnici sono prontamente disponibili a supportare i clienti e aiutare questi ultimi a massimizzare la copertura di test per le loro schede.”

I tempi di test possono risultare molto lunghi man mano che la complessità delle schede elettroniche aumenta; tuttavia, la collaborazione tra fornitori leader del mercato non solo sta aiutando ad affrontare le sfide dei tecnici di oggi, ma sta anche creando soluzioni pronte per il futuro.

parere

Stefano Ghibò
Technical Sales Specialist
SPEA

“Il test boundary scan ha diversi punti di forza che completano l’esperienza di SPEA nel campo del test. XJTAG è un tool potente e facile da usare, che ci permette di massimizzare i vantaggi di una soluzione boundary scan integrata per i nostri clienti.”

“Per completare l’integrazione tra le funzionalità del boundary scan e del test in-circuit, il team SPEA ha rielaborato la strategia di test globale per ottimizzare i tempi di ciclo di test. Il sistema combinato implementa anche un report di copertura di test che unisce i dati relativi alle diverse tecniche di test utilizzate.”

Scheda Aziendale	
Azienda	SPEA Spa. Sede centrale Italia
Tipo di attività	Leader mondiale nella progettazione e produzione di Automatic Test Equipment per microchip e schede elettroniche
Prodotti principali	Sistemi flying probe, letto d’aghi, e test funzionale
Clienti	A livello mondiale nel settore dei semiconduttori e dell’elettronica
Fondazione	1976
Dipendenti	Circa. 600
Località	Volpiano, Italia. Uffici dislocati in tutto il mondo.
Sito web	www.spea.com